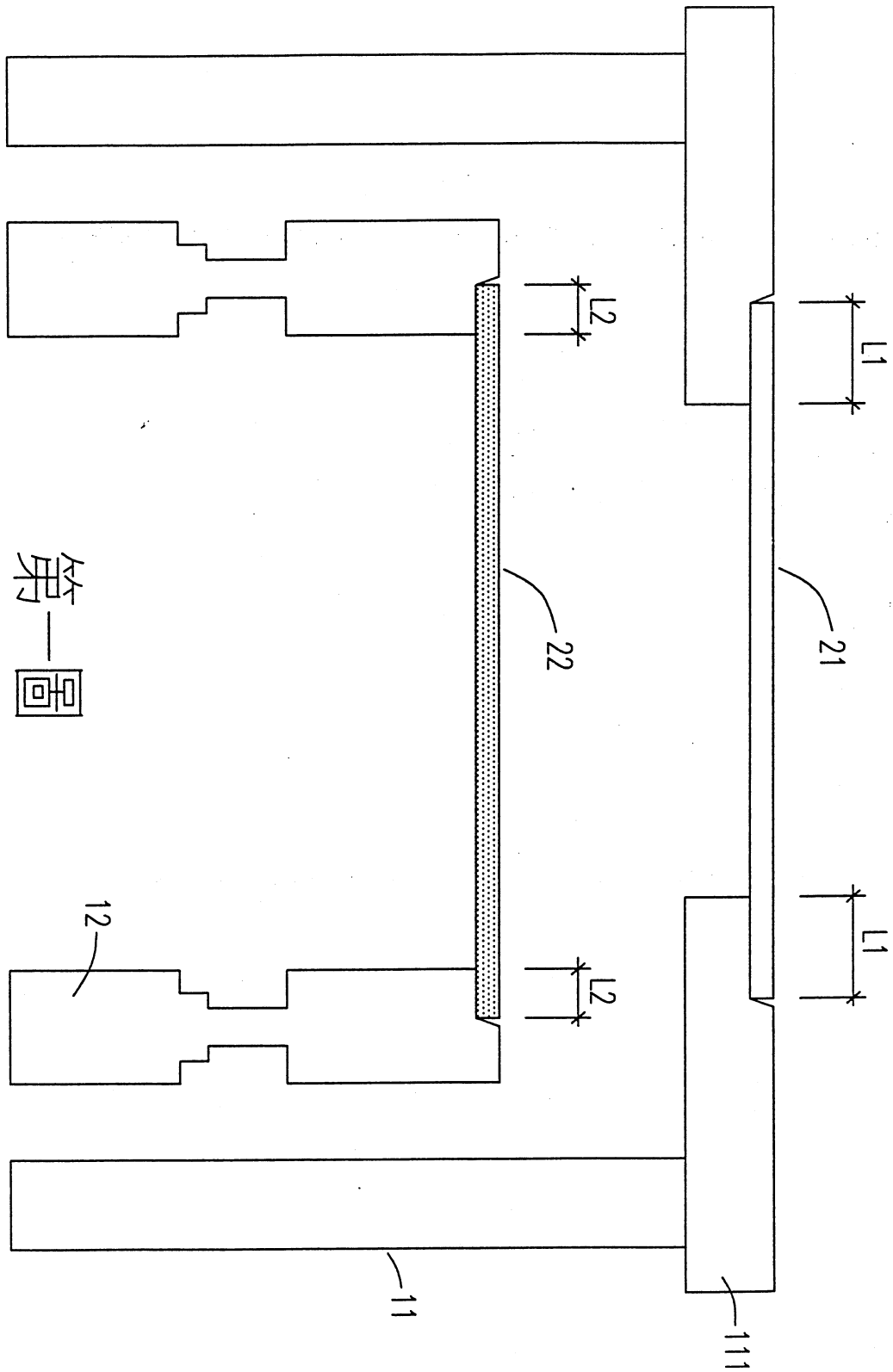
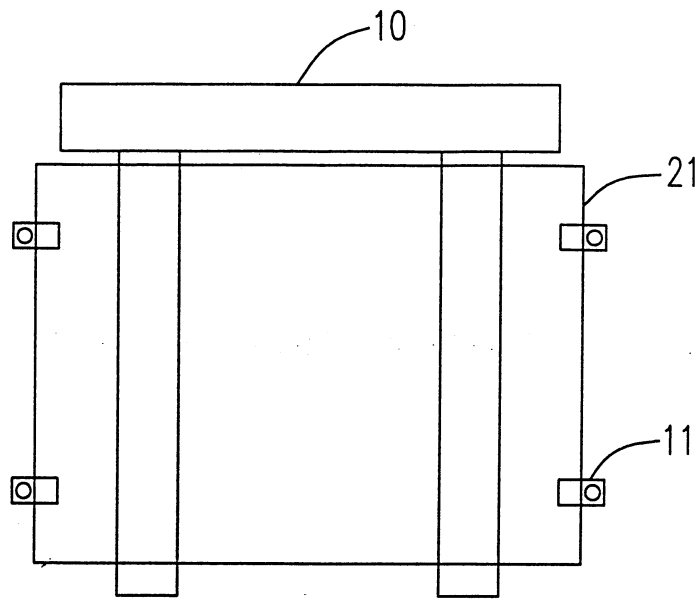


圖式

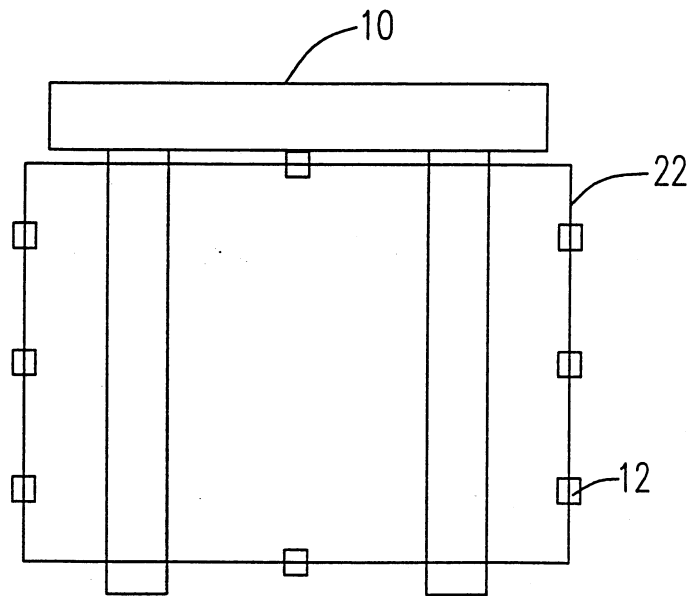


第一圖

圖式

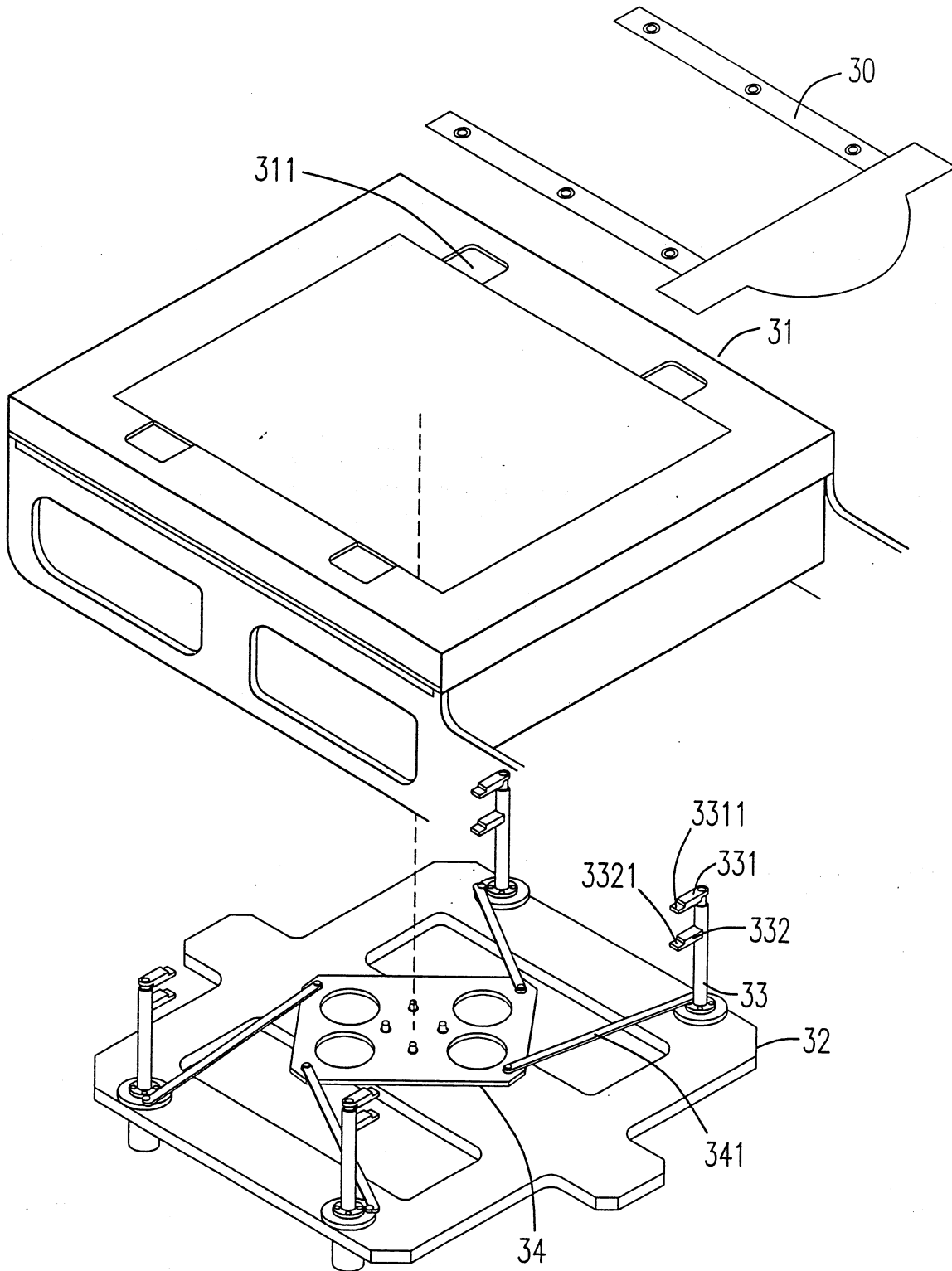


第二圖(A)



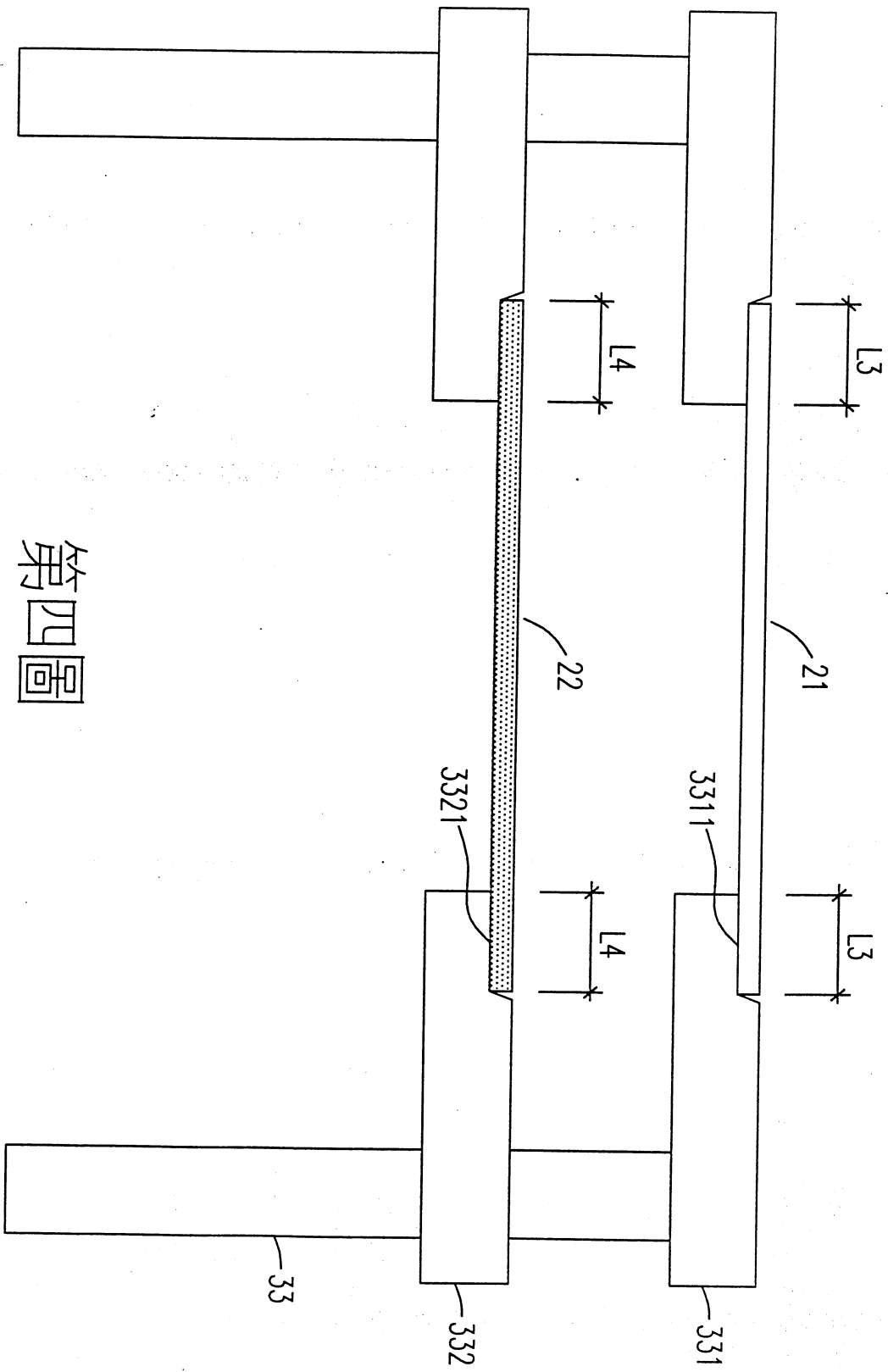
第二圖(B)

圖式



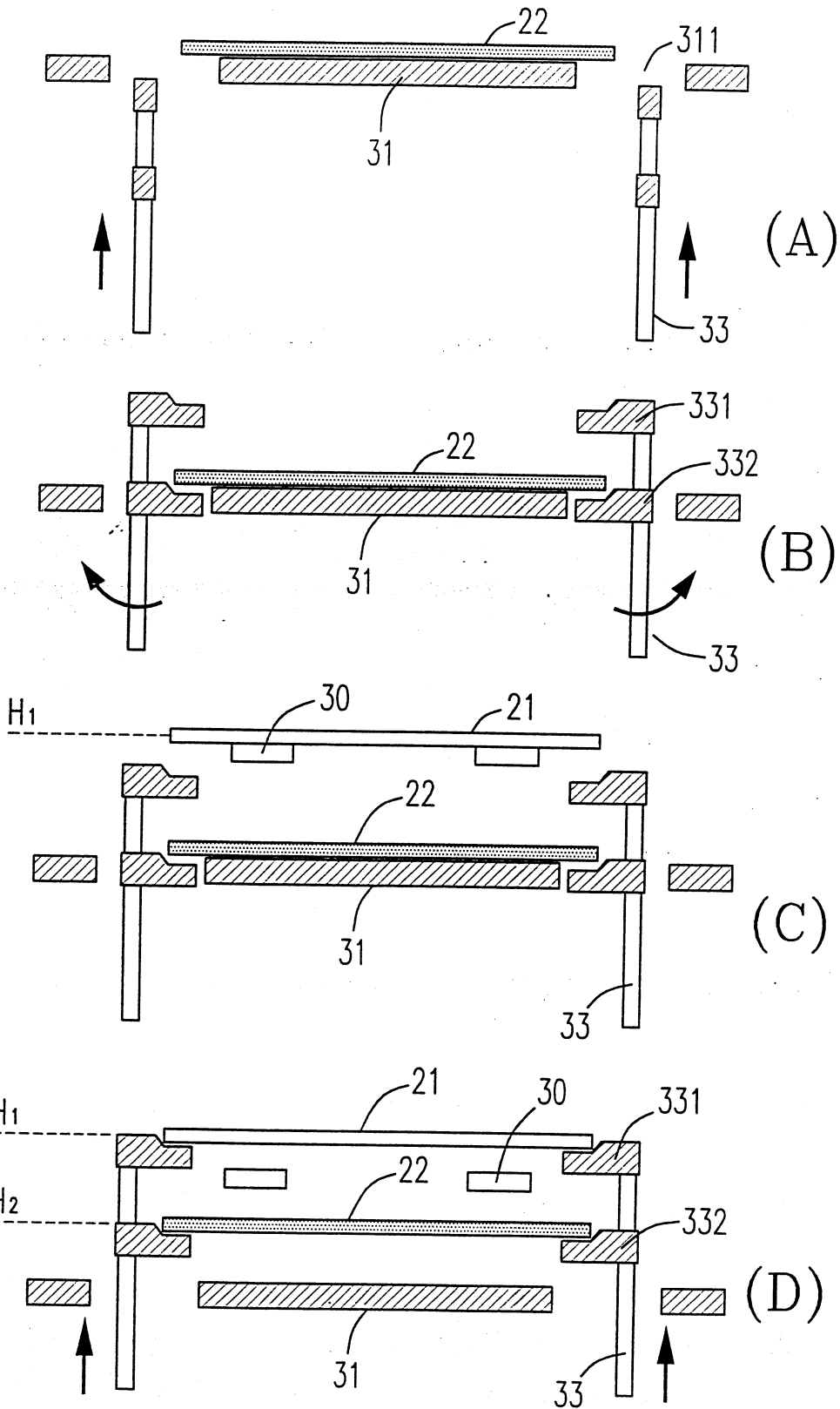
第三圖

圖式



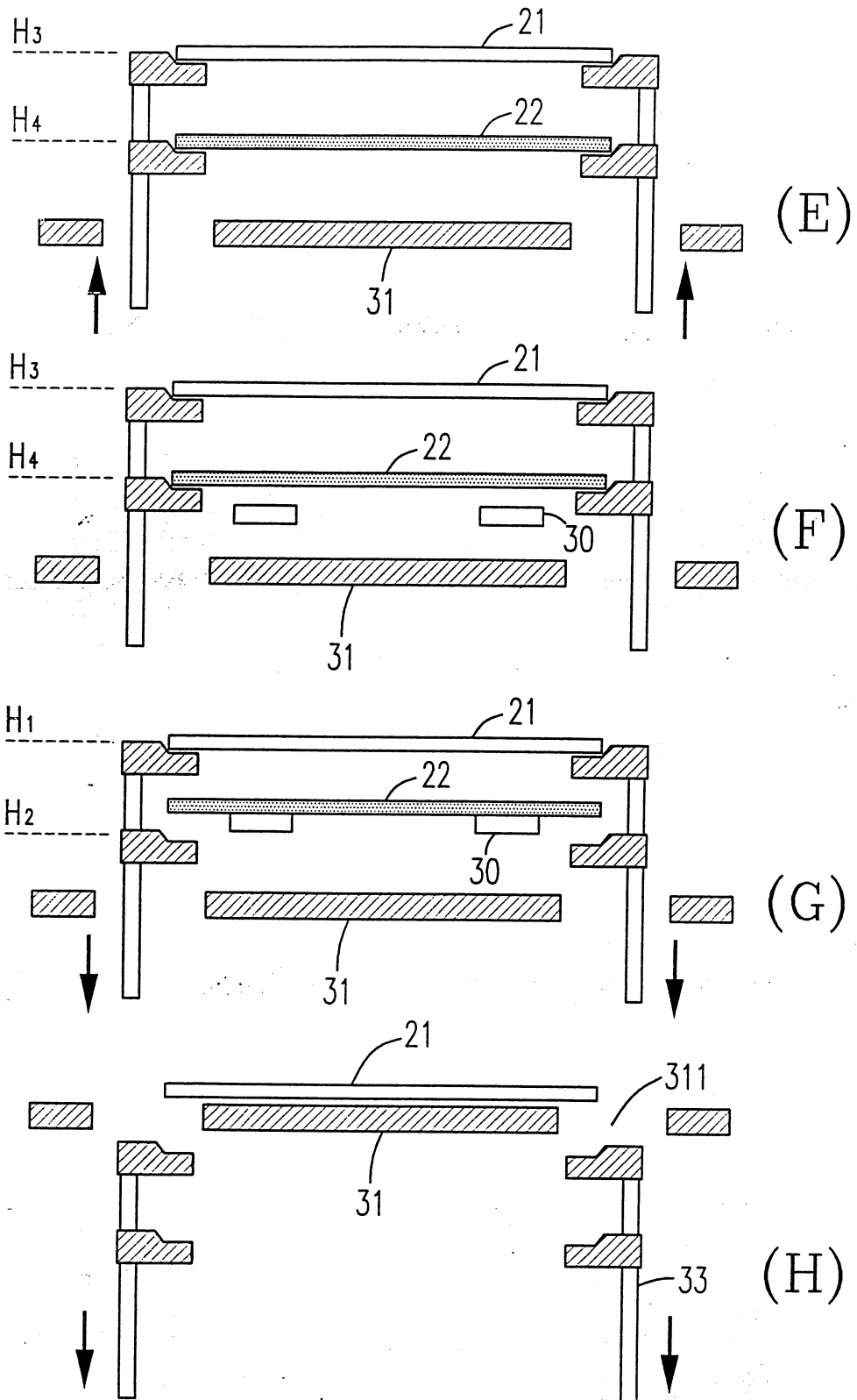
第四圖

圖式

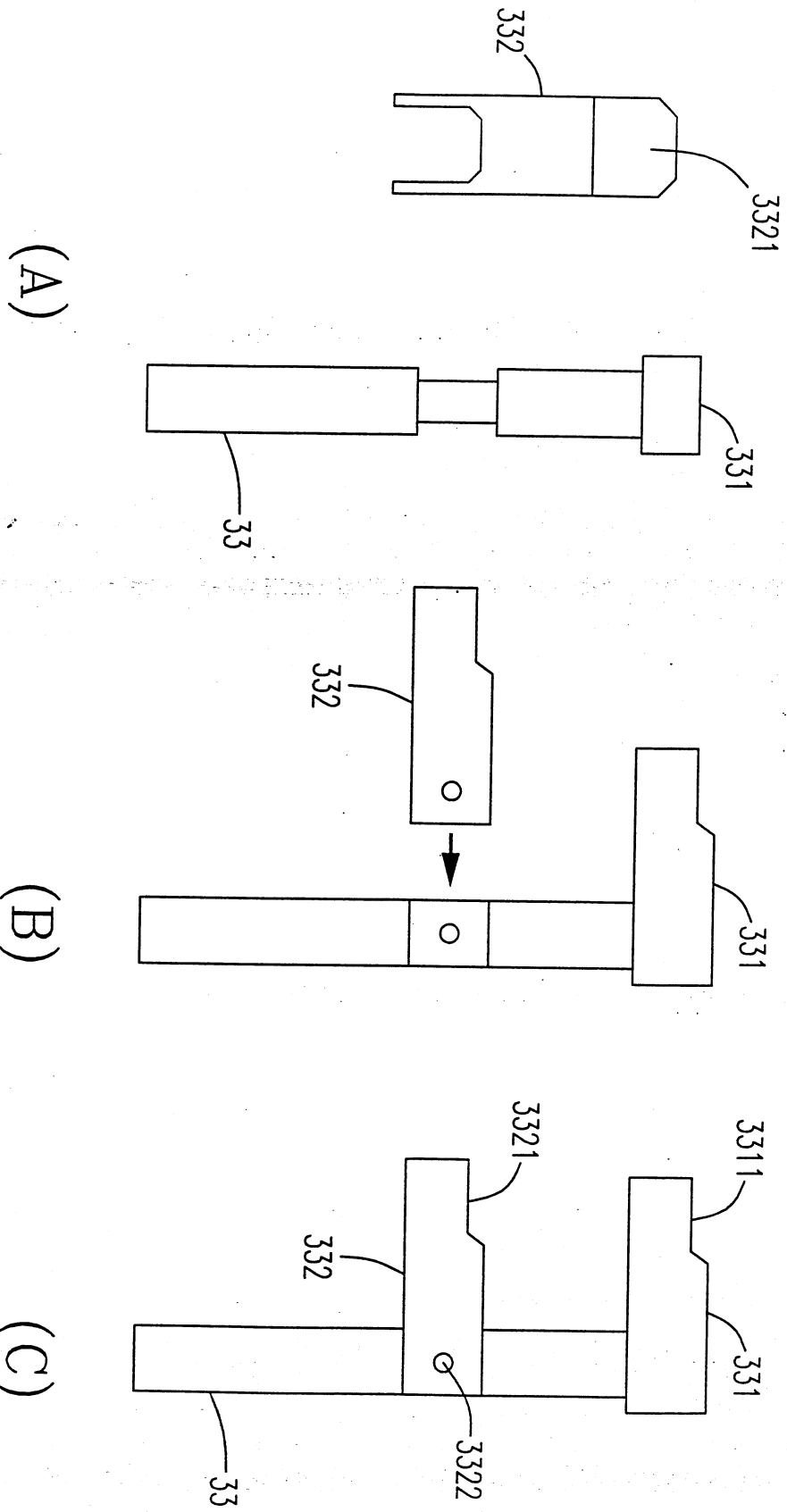


第五圖

圖式



第五圖



第六圖

本 告

94年6月8日修(更)正本

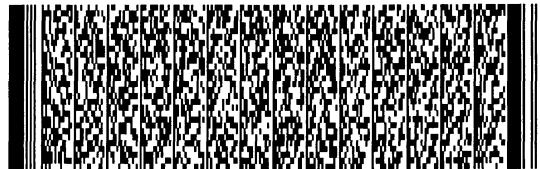
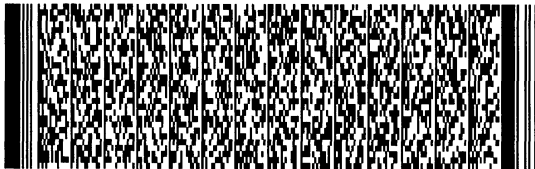
I286529

申請日期： 93/5/6	IPC分類 665G 47/52, 49/05
申請案號： 093112816	

(以上各欄由本局填註)

發明專利說明書

一、 發明名稱	中文	承接傳送方法及其使用之結構
	英文	METHOD AND STRUCTURE FOR RECEPTION AND DELIVERY
二、 發明人 (共3人)	姓名 (中文)	1. 戴溥男 2. 陳慶運 3. 鄭宏偉
	姓名 (英文)	1. TAI PO NAN 2. CHEN CHING YUN 3. CHENG HUNG WEI
	國籍 (中英文)	1. 中華民國 TW 2. 中華民國 TW 3. 中華民國 TW
三、 申請人 (共1人)	名稱或姓名 (中文)	1. 瀚宇彩晶股份有限公司
	名稱或姓名 (英文)	1. HannStar Display Corp.
	國籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
	住居所 (營業所) (中文)	1. 326-42桃園縣楊梅鎮高獅路580號 (本地址與前向貴局申請者不同)
	住居所 (營業所) (英文)	1. No. 580, Kao Shi Road, Yang-Mei, Tao-Yuan Hsien 326, Taiwan, R.O.C.
	代表人 (中文)	1. 焦佑麒
代表人 (英文)	1. Yu-Chi Chaio	



申請日期：	IPC分類
申請案號：	

(以上各欄由本局填註)

發明專利說明書

一、 發明名稱	中文	
	英文	
二、 發明人 (共3人)	姓名 (中文)	3. 鄭宏偉
	姓名 (英文)	3. CHENG HUNG WEI
	國籍 (中英文)	3. 中華民國 TW
	住居所 (中文)	3. 台北縣新莊市中信街9號11樓
	住居所 (英文)	3. 11F., No. 9, Jhongsin St., Sinjhuang City, Taipei County 242, Taiwan
三、 申請人 (共1人)	名稱或姓名 (中文)	
	名稱或姓名 (英文)	
	國籍 (中英文)	
	住居所 (營業所) (中文)	
	住居所 (營業所) (英文)	
	代表人 (中文)	
	代表人 (英文)	



一、本案已向

國家(地區)申請專利

申請日期

案號

主張專利法第二十四條第一項優先權

無

二、主張專利法第二十五條之一第一項優先權：

申請案號：

無

日期：

三、主張本案係符合專利法第二十條第一項第一款但書或第二款但書規定之期間

日期：

四、有關微生物已寄存於國外：

寄存國家：

寄存機構：

寄存日期：

寄存號碼：

無

有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構)：

寄存機構：

寄存日期：

寄存號碼：

無

熟習該項技術者易於獲得,不須寄存。



五、發明說明 (1)

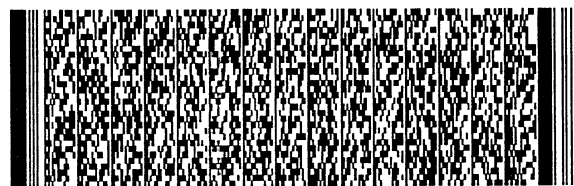
【發明所屬之技術領域】

本發明是關於一種承接傳送方法及其使用之結構，特別是關於一種在機台中可有效提昇物件運送安全性與穩定性的承接傳送方法及其使用之結構。

【先前技術】

現今的電子製造領域中，各種不同電子元件均需要在各種不同的機台上進行處理，而如：電鍍、蝕刻、沉積、濺鍍、封裝、測試等各種製程多需要在一密閉環境甚至為無塵狀態的處理機台中進行。過去多是透過一輸送帶或是一傳送裝置將該電子元件分次送入此等處理機台以進行處理，待該處理機台處理完後由另一端送出以進行下一段製程。惟，目前生產線中大多具有眾多不同的製程，倘若每一製程皆使用此種傳送方式則整條生產線需要配置相當長的輸送距離並佔用太多空間，使得該電子元件在傳輸過程中被外界污染或是意外損壞的可能性大為提高。同時，該處理機台在該電子元件移入與移出皆需要分別開啟，也大提高了該處理機台被污染的機台。此外，單一生產機台往往造價高昂，倘若每一生產線均購置該處理機台則製造成本會過高。

目前常採用僅具有單一入口之處理機台，所有電子元件皆由該單一入口進出以減少傳輸距離降低元件損壞污染的機會，而由此種該電子元件由該單一入口進出該處理機台的過程，通常是先由一傳送裝置送入一片待處理的電子

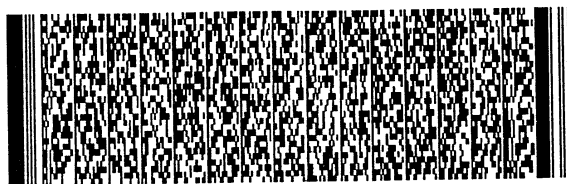
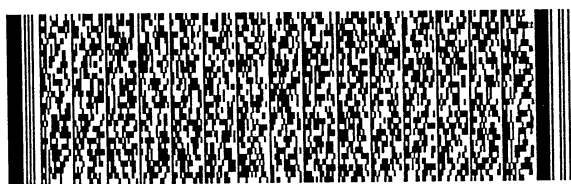


五、發明說明 (2)

元件至該處理機台，接著在由該處理機台中取出已處理的電子元件，因此該處理機台中需要一承接裝置以協助該電子元件移入與移出。

請參見第一圖，其係為習用處理機台之承接裝置，其主要係透過控制兩種不同高度的第一支撐桿11和第二支撐桿12之升降來分別承接由一傳送裝置10所（參見第二圖所示）載入之一第一物件21與取出之一第二物件22，其中該第一支撐桿11具有一承接架111用以承接該第一物件21，隨即降下以將該第一物件21放置在該機台中的承載平台（圖中未揭示）上，該第二支撐桿12係將該第二物件22由該承載平台上頂起以供該傳送裝置取回。第二圖（A）和（B）則分別為當該傳送裝置13送入該第一物件21和移出該第二物件22之俯視圖，而該第一物件21係由四個該第一支撐桿11所承接以及該第二物件22係由八個該第二支撐桿12所承接。

由於該第一支撐桿11配置在機台外的外側，第二支撐桿12則配置在機台內的外側，因此所能承接物件的接觸面積也不同。如第一圖所示，該第一支撐桿11可承接到該第一物件21兩側的長度為 L_1 ，而該第二支撐桿12僅可承接該第二物件22兩側的長度為 L_2 ，由於 L_2 小於 L_1 ，造成該第二支撐桿12所能承接的接觸面積較第一支撐桿11所能承接的接觸面積小，因此若因該傳送裝置10的操作機械誤差或是機台處理時的震動往往會使得該第二物件22的位置偏移，進而大幅增加該第二物件22滑落的機會。



五、發明說明 (3)

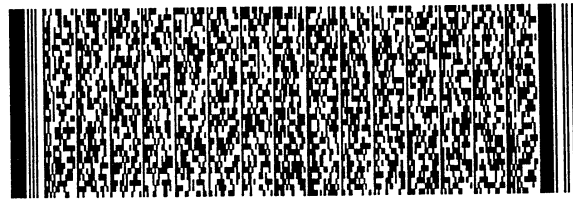
惟，當該第二物件22滑落除了會損壞該第二物件22外，還會破壞該承載平台或是該處理機台內其他設備而使該處理機台當機，進而必須將整條生產線停工以派遣維修人員進入該處理機台內清理被破壞的第二物件22、更換受損壞的設備，而這些清理與維修之相關步驟皆為相當的耗時費事，並影響生產效率，對於分秒必爭的製造業者而言，這將是一個急需解決及改善的問題。同時被破壞的第二物件22所殘留之碎屑，亦會對該處理機台造成污染，並因而降低生產良率。

縱上所述，由於目前機台中之物件承接技術在實際應用上仍具有缺失，因此發明人有鑑於上述習知技術之缺失而發明出本案「物件承接方法及其使用之結構」。

【發明內容】

本案之主要目的在於提供一種承接傳送方法及其使用之結構，透過簡單的結構配置與所提供的操作控制流程，使得機台上的物件運送不易產生滑移破損，降低生產線停工與維修的機會，有效節省成本與時間。

本案之另一目的在於提供一種承接傳送方法及其使用之結構，其在一組可升降之支撐架分別設置兩個不同高度之承接架，僅需控制此支撐架的升降與該承接架之方向轉變而讓物件安全穩定地載入與取出，由於該承接架設置在相同支撐桿上並具有相同承接物件的接觸面積，因此容易定位該物件而有效降低滑移掉落的機會，提高生產效率。



五、發明說明 (4)

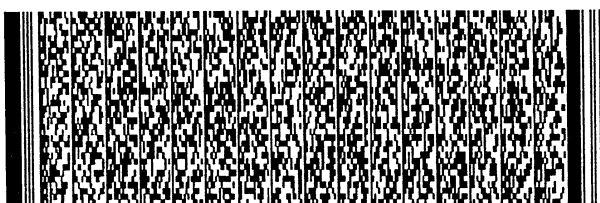
本案之又一目的為提供一種承接運送方法，其係包含下列步驟：利用一傳送裝置載入一第一物件於一第一位置，且一第二物件承載於一承載平台上，提供一支撐桿，包含一第一承接架與一第二承接架，調整該支撐桿及該傳送裝置之相對距離，使該第一承接架承接該第一物件於一第一位置，且該第二承接架承接該第二物件於一第二位置，利用該傳送裝置取出該第二物件，以及調整該支撐桿及該承載平台之相對距離，將該第一物件置於該承載平台上。

根據上述構想，該第一承接架與該第二承接架間的距離為定值，且該第一承載部用以承接該第一物件的面積，與該第二承載部用以承接該第二物件的面積相等，而當載入該第一物件於該第一位置時，該第二承接架位於該承載平台處。

根據上述構想，該承接運送方法更包含：當該第一承接架承接該第一物件於一第一位置，且該第二承接架承接該第二物件於一第二位置後，於該第一位置與該第二位置之間，調整該支撐桿及該傳送裝置之相對距離。

根據上述構想，該承接運送方法更包含：當調整該支撐桿及該傳送裝置之相對距離於該第一位置與該第二位置之間後，調整該支撐桿及該承載平台之相對距離，使該第一承接架位於一第三位置，且該第二承接架位於一第四位置。

根據上述構想，該第一位置等於該第三位置，該第二



五、發明說明 (5)

位置等於該第四位置。

根據上述構想，該承接運送方法更包含：當該第一承接架位於後第三位置，且該第二承接架位於該第四位置後，於該第四位置與該承載平台之間，調整該支撐桿及該傳送裝置之相對距離。

根據上述構想，該承接運送方法更包含：當調整該支撐桿及該傳送裝置之相對距離於該第四位置與該承載平台之間後，調整該支撐桿及該承載平台之相對距離，使該第一承接架位於該第一位置，且該第二承接架位於該第二位置。

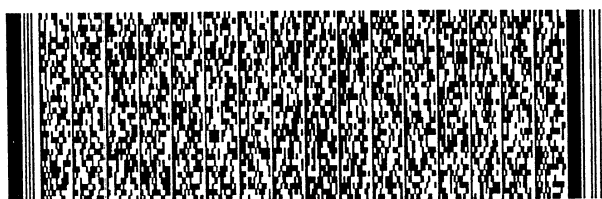
根據上述構想，該承接運送方法更包含：當該第一物件置於該承載平台後，視該第一物件為該第二物件。

根據上述構想，該承接運送方法更包含：當該第一物件被視為該第二物件後，旋轉該支撐桿。

根據上述構想，該承接運送方法更包含：當旋轉該支撐桿後，調整該支撐桿及該承載平台之相對距離，使該第二承接架位於該承載平台處。

根據上述構想，該承接運送方法更包含：當該第二承接架移動至該承載平台處後，逆向旋轉該支撐桿。

本案之再一目的為提供一種處理機台，用以處理一第一物件使其成為一第二物件，該處理機台包含一承接傳送結構，且該承接傳送結構包含：一升降平台，以及一支撐桿，配置於該升降平台上，該支撐桿包含一第一承接架與一第二承接架相鄰於該第一承接架，其中該第一承接架用



五、發明說明 (6)

以承接該第一物件，而該第二承接架用以承接第二物件。

根據上述構想，該處理機台更包含一承載平台，具有一孔洞對應於該支撐桿，而該第一物件係擺放在該承載平台上進行處理，以成為該第二物件。

根據上述構想，該處理機台更包含一運送裝置，用以載入該第一物件與取出該第二物件。

根據上述構想，該處理機台更包含一轉盤，配置於該升降平台上，並連結於該支撐桿，用以旋轉該支撐桿。

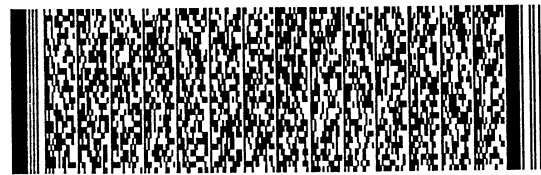
根據上述構想，該第一承接架具有一第一承載部用以承接該第一物件，且該第二承接架具有一第二承載部用以承接該第二物件，第一承載部與該第二承載部皆為一凹槽結構，該第一承接架與該第二承接架係透過一鑲嵌方式，配置於該支撐桿上。

根據上述構想，該第一物件與第二物件係選自一玻璃基板、電路板、晶圓片與平面電子元件其中之一，該處理機台係選自一濺鍍、電鍍、蝕刻、沉積、封裝、測試與其它需於密閉環境下作業之處理設備（簡稱密閉環境處理設備）其中之一。

本案之功效與目的，可藉由下列實施方式與圖示說明，俾有更深入之了解。

【實施方式】

將於下文中說明本發明，請參考附圖，熟悉本技術者須瞭解下文中的說明僅係作為例證用，而不用於限制本發



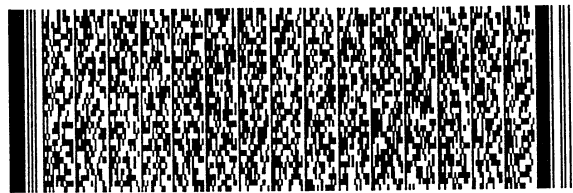
五、發明說明 (7)

明。

以下針對本案較佳實施例的處理機台進行描述，但實際之結構配置及所採行之方法並不必須完全符合描述之結構與方法，熟習本技藝者當能在不脫離本發明之實際精神及範圍的情況下，做出種種變化及修改。

請參閱第三圖，本案之較佳實施例之一種處理機台之架構示意圖。本案處理機台主要包含有一承載平台31和一升降平台32，該承載平台31即是供物件（21、22，請參見第四圖所示）放置以進行處理，而該升降平台32係設置該承載平台31的正下方，並配置有一組共四個支撐桿33，每一支撐桿33係在不同高度上水平架設一第一承接架331和一第二承接架332，而該第一承接架331與該第二承接架332間之距離為一定值，且該承載平台31在對應於該支撐桿33位置之對應位置具有對應孔洞311，因此當該升降平台32上升時，該支撐架33即可透過該承載平台31之對應孔洞311而順利升起。此外，該升降平台32上更具有一轉輪34，該轉輪34係透過該轉輪34上之連桿341分別與該支撐桿33連結以控制該支撐桿33上之該第一承接架331與該第二承接架332方向的轉變。而本案就是透過控制該升降平台32的升降與該第一承接架331與該第二承接架332的轉動以分別承接一傳送裝置30欲運送之一第一物件21與一第二物件22，進而可以達成本案所揭示之安全地將物件載入或取出之發明目的。

請參見第四圖，其係本案處理機台分別承接有該第一

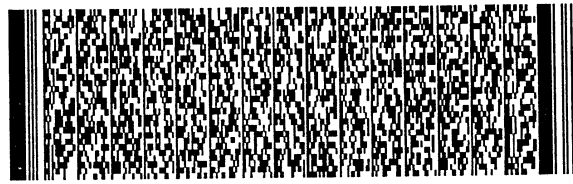


五、發明說明 (8)

物件與該第二物件之剖面簡圖。該支撐桿33上之第一承接架331係用以承接該第一物件21，而在該支撐桿33上具較低高度之第二承接架332係用以承接該第二物件22，相較於習用技術，本案僅需單一種類支撐桿33即可提供該第一物件21與該第二物件22的承接功效，且本案之該第一承接架331與該第二承接架332上皆具有一具凹槽形式之一第一承載部3311與一第二承載部3321分別以與該第一物件21與該第二物件22接觸以支撐並定位該第一物件21與該第二物件22，且該第一承載部3311與該第二承載部3321均具有相同的長度 ($L3=L4$) 與相同之接觸面積，因此可避免該傳送裝置30操作時的機械誤差而使該第一物件21或該第二物件22滑落。其較佳者，更可於該第一承載部3311與第二承載部3321的接觸面上進行防滑處理，以加強該第一物件21與該第二物件22傳送之穩定性。

請參見第五圖 (A) 至 (H)，其係為本案承接傳送方法之流程示意圖。第五圖 (A) 係為該第二物件22放置在一處理機台之承載平台31上進行處理，此時該支撐桿33與該第一承接架331與該第二承接架332分別位於該承載平台31下方，當該第二物件22處理完畢，透過一升降平台32 (請參閱第三圖) 升起該支撐桿33，透過調整該支撐桿33及該承載平台31之相對距離，以避免該支撐桿33升起時而在該第一承接架331穿越一孔洞311時會碰觸到位於該承載平台31處的該第二物件22。

如第五圖 (B) 所示，當該支撐架33上升至該承接架



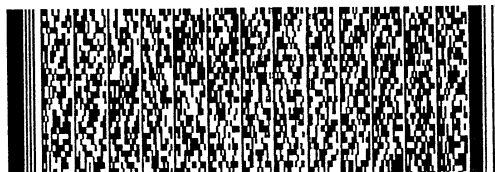
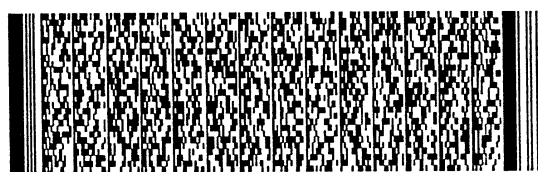
五、發明說明 (9)

332 接近該承載平台31的位置時，也就是當該第一承接架331與該第二承接架332分別位於該承載平台31上方處與平行於該承載平台31邊緣處時，透過一轉輪34（請參閱第三圖）逆向旋轉該支撐桿33以使該第一承接架331與該第二承接架332轉向為垂直於該承載平台31之邊緣，以協助承接該第二物件22。

即如第五圖（C）所示，調整該支撐桿33及該載有該第一物件21的傳送裝置30之相對距離，以將該傳送裝置30移動到該承載平台31上方的一第一位置H1處，準備將該第一物件21載入，此時該第一承接架331和該第二承接架332仍是位於第五圖（B）所示之位置處，而該第二物件22亦位於該承載平台31處，準備由該第二承接架332進行承接該第二物件22。

如第五圖（D）所示，調整該支撐桿33及該承載平台31之相對距離，升起該支撐桿33至該第一位置H1處，以透過該第一承接架331將該第一物件21頂起，同時，該第二承接架332也將放置在該承載平台31的該第二物件22承接傳送至一第二位置H2處。

又如第五圖（E）所示，調整該支撐桿33及該傳送裝置30之相對距離，以退出該傳送裝置30後，調整該支撐桿33及該承載平台31之相對距離，升起該支撐桿33，使該第一承接架331與該第二承接架332分別承接該第一物件21與該第二物件22於一第三位置H3處與一第四位置H4處。但若該機台內部的操作空間足夠，不移動該支撐桿33，而使該



五、發明說明 (10)

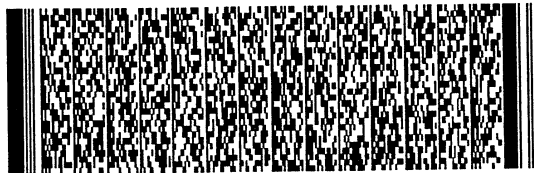
第一物件21與該第二物件22維持在原位置亦屬可行。

如第五圖(F)所示，調整該支撐桿33及該傳送裝置30之相對距離，使該傳送裝置30移入該承載平台31與該第二承接架332之間，準備承接該第二物件22，此時該下方承載架332與該第二物件22所在的該第四位置H4處的高度高於該傳送裝置30所在的高度。

如第五圖(G)所示，調整該支撐桿33及該承載平台31之相對距離，降下該支撐桿33，使得該第一承接架331與該第二承接架332分別位於該第一位置H1處與該第二位置H2處，而使該第二承接架332所承接之該第二物件22恰可放置在該傳送裝置30上。或者是不改變該第一承接架331與該第二承接架332的位置，而是移動該傳送裝置30的位置使其將該第二物件22自該第四位置H4處取下。

如第五圖(H)所示，調整該支撐桿33及該傳送裝置30之相對距離，待移出已載有已處理之該第二物件22的傳送裝置30後，調整該支撐桿33及該承載平台31之相對距離，降下該支撐桿33以使該第一承接架331所承接的該第一物件21恰可放置在該承載裝置31上，而該第一物件21即可在該承載裝置31進行處理，而該第一承接架331與該第二承接架332則繼續降下，並進一步旋轉為如第五圖(A)的狀態，待該第一物件21經處理變為第二物件22後，以重新進行本案之在機台中承接傳送物件之步驟。

其中，該第一物件21與該第二物件22可以是一玻璃基板、電路板或晶圓片等平板狀的電子元件，而該機台則可



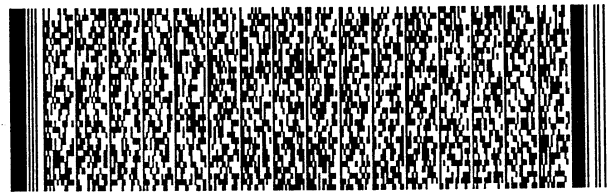
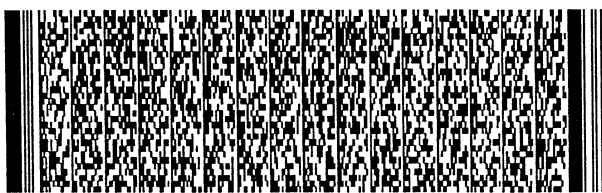
五、發明說明 (11)

以是一濺鍍機、一電鍍設備、一蝕刻機、沉積設備、封裝設備或測試設備等各式需於密閉環境下作業之的處理設備。該傳送裝置30則可以是一叉型之機械手臂。

此外，請參閱第六圖(A)至(C)，其係為本案的承接架與支撐桿的配置組合圖。本案之該第一承接架331與該第二承接架332係以鑲嵌方式套置在該支撐桿33上，其中第六圖(A)係分別為該第二承接架332之俯視圖和該支撐桿33之正視圖，而將該支撐桿33的對應位置削切，接著如第六圖(B)將該第二承接架332套置在該支撐桿33上，且在該第二承接架332的側邊和該支撐架側邊之對應部位均具有一固定孔3322，最後如第六圖(C)透過一螺絲或其他固定元件透過該固定孔3322將該第二承接架332與該支撐桿33固定，而透過側面至於該第一承接架331亦可用相同方式組裝，然本圖並未揭示。

倘若以光電業中之玻璃基板運送為實例，習知技術容易造成該玻璃基板破片，使得機台當機，而每次因破片當機後至少須花費12小時清理與修復才能復機，若採用本案技術後則可有效提高承接基板的穩定度以大幅降低破片機率而提高機台生產利用率、降低製造成本。

因此，本案改良了傳統電子元件在機台中移入或移出的模式，無須兩種不同設計的支撐桿，避免運作中常會有偏移而破損的機會。透過本案所提供的結構設計與單一的操作控管流程可有效增加電子元件在承接傳送中的穩定性，並降低生產線上的機台當機機會，節省成本與時間。

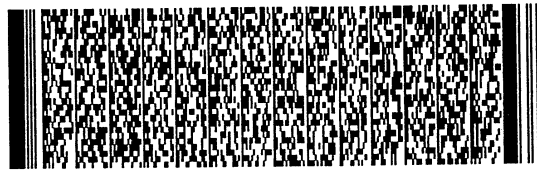
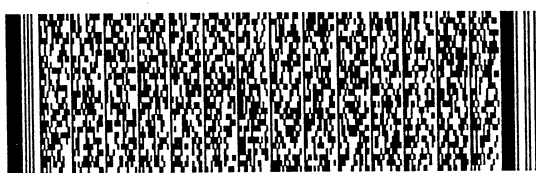


五、發明說明 (12)

綜上所述，本案確實可提供一種承接傳送方法及其使用之結構，係改變原有承接機制而採用單一支撐桿承接，在單一支撐桿上設置兩種不同高度的承接架，利用這些承接架與該支撐桿的升降來控制未處理之物件與已處理之物件在機台與該處理裝置間的移入和移出，以使該物件可迅速地送入與移出而不易產生滑移而破損，實具產業之價值，爰依法提出發明專利申請。

以上所述係利用較佳實施例詳細說明本發明，而非限制本發明的範圍，因此熟知此技藝的人士應能明瞭，適當而作些微的改變與調整，仍將不失本發明之要義所在，亦不脫離本發明之精神和範圍，故都應視為本發明的進一步實施狀況。謹請 貴審查委員明鑑，並祈惠准，是所至禱。

本案得由熟習此技術之人士任施匠思而為諸般修飾，然皆不脫本案申請專利範圍所欲保護者。



圖式簡單說明

第一圖係為習用處理機台之剖面示意圖。

第二圖 (A) 和 (B) 係分別為第一圖之處理機台分別承接第一物件與第二物件之俯視圖。

第三圖係為本案較佳實施例之一種處理機台之架構示意圖。

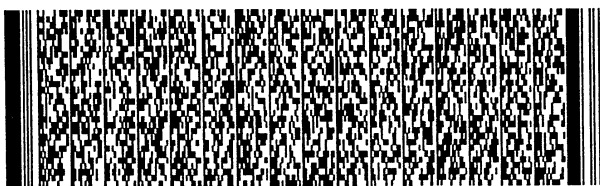
第四圖係為第三圖分別承接有第一物件與第二物件之剖面簡圖。

第五圖 (A) 至 (H) 分別為本案較佳實施例之承接傳送方法之流程示意圖。

第六圖 (A) 至 (C) 係為本案之承接架與支撐桿之組合圖。

圖號說明

10、30 傳送裝置	3311 第一承載部
11、33 第一支撐桿	3321 第二承載部
12 第二支撐桿	3322 固定孔
111 承接架	34 轉輪
331 第一承接架	341 連桿
332 第二承接架	L1、L2、L3、L4 長度
21 第一物件	H1 第一位置
22 第二物件	H2 第二位置
31 承載平台	H3 第三位置
311 孔洞	H4 第四位置
32 升降平台	



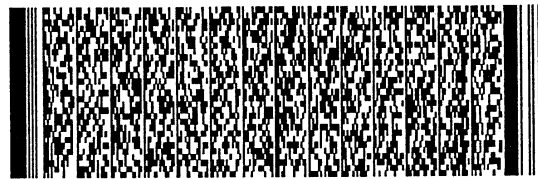
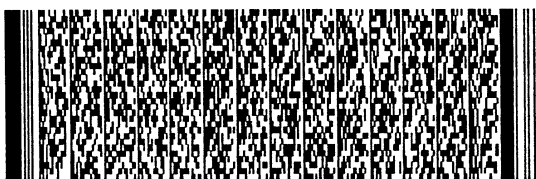
四、中文發明摘要 (發明名稱：承接傳送方法及其使用之結構)

本發明係提供一種承接傳送方法及其使用之結構，可在一處理機台中承接傳送載入之未處理物件，並將已處理之物件承接傳送載出。本發明所使用之承接傳送結構，包含一組可升降之支撐架，該支撐架分別設置有兩個不同高度之承接架，且該兩承接架皆具有相同接觸面積，以用以承接物件。因此，僅需控制此支撐架之升降與承接架之方向轉變，即可使讓物件安全穩定地移入與送出，不但容易定位物件，且可有效降低滑移掉落的機會，提高生產效率。

本案若有化學式，請揭示最能顯示發明特徵的化學式

五、英文發明摘要 (發明名稱：METHOD AND STRUCTURE FOR RECEPTION AND DELIVERY)

A method and a structure for reception and delivery are provided to receive a loaded and unprocessed object, and to transfer a processed object. The present structure includes a set of elevating supports. Two receiving racks with different heights are respectively mounted on the elevating support, and have the same contact areas for receiving the object. Therefore, only heights



四、中文發明摘要 (發明名稱：承接傳送方法及其使用之結構)

五、英文發明摘要 (發明名稱：METHOD AND STRUCTURE FOR RECEPTION AND DELIVERY)

of the supports and directions of the receiving racks are controlled so as to load and deliver the objects stably. The objects are not only positioned easily, but the possibility for the object to slip and drop is also efficiently decreased, so that the production efficiency of the object is enhanced.



六、申請專利範圍

1. 一種承接傳送方法，其係包含下列步驟：

利用一傳送裝置載入一第一物件於一第一位置，且一第二物件承載於一承載平台上；

提供一支撐桿，包含一第一承接架與一第二承接架，調整該支撐桿及該傳送裝置之相對距離，使該第一承接架承接該第一物件於一第一位置，且該第二承接架承接該第二物件於一第二位置；

利用該傳送裝置取出該第二物件；以及

調整該支撐桿及該承載平台之相對距離，將該第一物件置於該承載平台上。

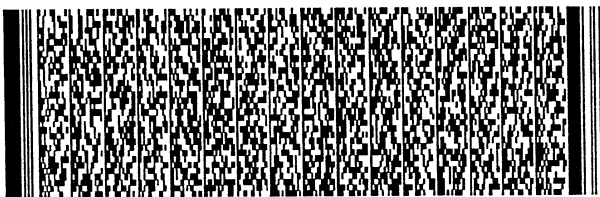
2. 如申請專利範圍第1項所述之承接傳送方法，其中，該第一承接架與該第二承接架間的距離為定值。

3. 如申請專利範圍第1項所述之承接傳送方法，其中，該第一承載部用以承接該第一物件的面積，與該第二承載部用以承接該第二物件的面積相等。

4. 如申請專利範圍第1項所述之承接傳送方法，其中，當載入該第一物件於該第一位置時，該第二承接架位於該承載平台處。

5. 如申請專利範圍第1項所述之承接傳送方法，更包含：當該第一承接架承接該第一物件於一第一位置，且該第二承接架承接該第二物件於一第二位置後，於該第一位置與該第二位置之間，調整該支撐桿及該傳送裝置之相對距離。

6. 如申請專利範圍第1項所述之承接傳送方法，更包含：



六、申請專利範圍

當調整該支撐桿及該傳送裝置之相對距離於該第一位置與該第二位置之間後，調整該支撐桿及該承載平台之相對距離，使該第一承接架位於一第三位置，且該第二承接架位於一第四位置。

7. 如申請專利範圍第6項所述之承接傳送方法，其中，該第一位置等於該第三位置。

8. 如申請專利範圍第6項所述之承接傳送方法，其中，該第二位置等於該第四位置。

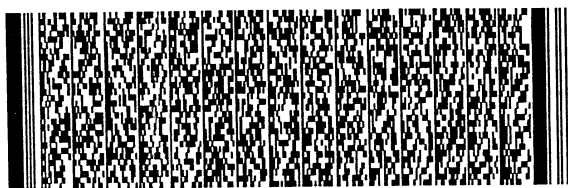
9. 如申請專利範圍第6項所述之承接傳送方法，更包含：
當該第一承接架位於後第三位置，且該第二承接架位於該第四位置後，於該第四位置與該承載平台之間，調整該支撐桿及該傳送裝置之相對距離。

10. 如申請專利範圍第9項所述之承接傳送方法，更包含：
當調整該支撐桿及該傳送裝置之相對距離於該第四位置與該承載平台之間後，調整該支撐桿及該承載平台之相對距離，使該第一承接架位於該第一位置，且該第二承接架位於該第二位置。

11. 如申請專利範圍第1項所述之承接傳送方法，更包含：
當該第一物件置於該承載平台後，旋轉該支撐桿。

12. 如申請專利範圍第11項所述之承接傳送方法，更包含：
當旋轉該支撐桿後，調整該支撐桿及該承載平台之相對距離，使該第二承接架位於該承載平台處。

13. 如申請專利範圍第12項所述之承接傳送方法，更包含：
當該第二承接架移動至該承載平台處後，逆向旋轉該



六、申請專利範圍

支撐桿。

14. 一種處理機台，該處理機台包含一承接傳送結構用以承接傳送已處理之一第一物件以及待處理之一第二物件，且該承接傳送結構包含：

一升降平台；以及

一支撐桿，配置於該升降平台上，該支撐桿包含一第一承接架與一第二承接架相鄰於該第一承接架，其中該第一承接架用以承接該第一物件，而該第二承接架用以承接第二物件。

15. 如申請專利範圍第14項所述之處理機台，更包含：

一承載平台，具有一孔洞對應於該支撐桿，而該第一物件係擺放在該承載平台上進行處理，以成為該第二物件。

16. 如申請專利範圍第14項所述之處理機台，更包含：

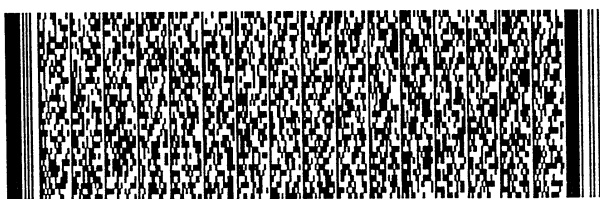
一運送裝置，用以載入該第一物件與取出該第二物件。

17. 如申請專利範圍第14項所述之處理機台，更包含：

一轉盤，配置於該升降平台上，並連結於該支撐桿，用以旋轉該支撐桿。

18. 如申請專利範圍第14項所述之處理機台，其中，該第一承接架具有一第一承載部用以承接該第一物件，且該第二承接架具有一第二承載部用以承接該第二物件。

19. 如申請專利範圍第18項所述之處理機台，其中，該第一承載部與該第二承載部皆為一凹槽結構。



六、申請專利範圍

20. 如申請專利範圍第19項所述之處理機台，其中，該第一承載部用以承接該第一物件的面積，與該第二承載部用以承接該第二物件的面積相等。

21. 如申請專利範圍第14項所述之處理機台，其中，該第一承接架與該第二承接架係透過一鑲嵌方式，配置於該支撐桿上。

22. 如申請專利範圍第14項所述之處理機台，其中，該第一物件與第二物件係選自一玻璃基板、電路板、晶圓片與平面電子元件其中之一。

23. 如申請專利範圍第14項所述之處理機台，其中，該處理機台係選自一濺鍍、電鍍、蝕刻、沉積、封裝、測試與密閉環境處理設備其中之一。



六、指定代表圖

(一)、本案代表圖為：第三圖

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明：

30 傳送裝置

31 承載平台

311 孔洞

32 升降平台

33 支撐桿

331 第一承接架

332 第二承接架

34 轉輪

